

第35回 マイクロエレクトロニクスシンポジウム2025



一般社団法人 エレクトロニクス実装学会

MES2025

開催日・講演発表日：2025年9月3日(水)～5日(金)

開催会場：大阪大学中之島センター（大阪市）& オンライン開催

◀MES2025ホームページ▶

<https://jiep.or.jp/event/mes/mes2025/>



交流会：9月4日(木)17:40～19:30

会場：レストランアラスカ フェスティバルタワー

【プログラム】

※変更する場合もございますので、最新の情報はMES2025ホームページをご確認ください

2025.8.25

MES2025 プログラム（特別セッション）				
2025年9月3日（水） 開始時間 13:00 【受付開始 12:20】				
A会場（10階ホール3・4）	B会場（10階ホール1・2）	C会場（7階セミナー室7C・7D）	D会場（7階セミナー室7A・7B）	
ロードマップ セッション	第54回電子デバイス実装研究委員会 共催 （スマートプロセスエレクトロニクス生産部会主催） 「未来社会をつなげるスマート実装技術」	特別企画セッション ガラスコアサブストレート	若手大活躍推進セッション	
13:00 3A1-1 AI/MLとxEVを牽引する半導体実装技術 -JEITA 2024年度実装技術ロードマップの 一部更新- 尾崎裕司 氏 (Semicon RobusSearch)	13:00 3B1-1 (0120) 「誰でも簡単、短期間、安価に、IoTソリューション 創出基盤の開発と実証」 勝村英則 氏 ((同)かちクリエイト)	13:00 3C1-1 (0113) 「ガラス基板実装のこれまでの推移と動向、ならびに 関連要素技術」 大西哲也 氏 (Grand Joint Technology Ltd.)	13:00 3D1-1 (0119) 【依頼講演】 「未来のエレクトロニクス実装技術を切り拓く」 西川英信 氏 (パナソニックホールディングス㈱)	
	13:40 3B1-2 (021) 「“ウェアラブルデバイス”実現のためのニットセンサ作製に 関する研究」 泉小波 氏 ((国研)産業技術総合研究所)		13:50	休憩（10分）
14:00 3A1-2 ガラス・サブストレートの技術動向 -JEITA 2024年度実装技術ロードマップ プリント配線板- 宇都宮久修 氏 (インターコネクションテクノ ロジーズ ㈱)	14:20 3B1-3 (0122) 「液体金属を使用した高耐久伸縮回路基板につ いて」 清水良太 氏 (㈱サトーセン)	14:00 3C1-2 (0114) 「ガラスへのCuめっき技術の現状とGWC直接Cuめ っきの紹介」 原田次郎 氏 (江東電気㈱)	14:00 3D2-1 若手大活躍セッション 若手ライトニングトーク	
		14:30 3C1-3 (0115) 「ガラス洗浄の重要性と評価方法、TGVガラス洗浄 における課題」 西座弘明 氏 (㈱パーカーコーポレーション)		
15:00	休憩（10分）			
15:10 3A2-1 光回路実装技術ロードマップセッション 2022年度版ロードマップの概要と検証 大畠伸夫 氏 (三菱電機㈱)	15:10 3B2-1 (0123) 「局所誘導加熱を利用した非接触はんだ付けにお ける省エネ技術について」 熊田泉実 氏 (㈱スフィクス・テクノロジーズ)	15:10 3C2-1 (0116) 「割断によるガラスの切断加工」 留井直子 氏 ((同)プリマテック)	15:10 3D3-1 若手大活躍セッション パネルディスカッション	
	15:50 3B2-2 (0124) 「深層学習による非破壊・三次元クラック検出と信 頼性寿命予測への活用」 長谷川将司 氏 (㈱クオルテック)	15:40 3C2-2 (0125) 「TGV基板向け高密着表面処理プロセス」 吉川純二 氏 (奥野製薬工業㈱)		
16:10 3A2-2 (0118) 部品内蔵ロードマップセッション 「部品内蔵技術ロードマップ2025年度版に向 けて」 松澤浩彦 氏 部品内蔵技術委員会ロードマップ研究会 幹事 (㈱図研)	16:30	16:10 3C2-3 (0117) 「ここまで来ているガラスコアサブストレート・インター ポーザー」 八甫谷明彦 氏 (よこはま高度実装技術コンソーシ アム)	16:20	
17:10	終了			

MES2025 プログラム（一般講演・企業セッション・ポスターセッション・表彰式・特別講演）					
2025年9月4日（木）開始時間 9:00 【受付開始 8:20】					
A会場(10階ホール3・4)		B会場(10階ホール1・2)		C会場（7階セミナー室7C・7D）	
D会場（7階セミナー室7A・7B）					
プリンタブル・ウェアラブル・バイオエレクトロニクス、環境調和型エレクトロニクス		第39回春季講演大会 受賞講演		めっき技術	
高速高周波実装・電磁特性技術					
9:00	4A1-1 (0111) 【依頼講演】 「イオン導電性高分子ソフトアクチュエータ・センサの開発」 物部浩達 氏 ((国研)産業技術総合研究所)	9:00	4B1-1 (0103) 「マルチバイタルセンシングのためのE-スポンジの開発」 佐藤優(東京大学)	9:00	4C1-1 (0042) 「リフロー実装対応のはんだ付け性試験前処理による金属腐蝕化合物の影響に関する検討」 泉水崇彰(TDK㈱)
		9:15	4B1-2 (0104) 「片方のカットオフ周波数のみを調整可能な広帯域チューナブルBPFの設計に関する検討」 松木淳一郎(電気通信大学)	9:20	4C1-2 (0019) 「低温Cu-Cu接合用硫酸銅めっき添加剤」 神埜大軌(奥野製薬工業㈱)
		9:30	4B1-3 (0105) 「高密度CNTフォレストによるTIM開発」 奥村友貴(静岡大学)	9:40	4C1-3 (0045) 「無電解めっきプライマー層への紫外光照射によるめっき触媒活性制御の検討」 中澤悠人(㈱イオックス)
9:40	4A1-2 (0016) 「接着剤フリー実装技術による皮膚貼付け型角度センサの開発」 高桑聖仁(東京大学,理化学研究所)	9:45	4B1-4 (0106) 「Ag拡散接合を用いた10μmピッチCuバリの低温・低荷重・短時間接合技術」 桂尊晴(大阪大学,京都工芸繊維大学)	9:40	4D1-3 (0062) 「複数の周波数分散モデルを用いた超軽量電波吸収体における電磁特性の推定に関する検討」 鈴木暖(東北大学)
10:00	休憩（10分）				
プリンタブル・ウェアラブル・バイオエレクトロニクス、環境調和型エレクトロニクス		第39回春季講演大会 受賞講演		めっき技術	
高速高周波実装・電磁特性技術					
10:10	4A2-1 (0059) 「導電性印刷配線の3D成形における動的パーコレーションの影響因子」 相田莉奈(群馬大学)	10:10	4B2-1 (0107) 「高信頼性アンダーフィル材開発のための内部ひずみに着目した寿命解析手法」 吉田拓弥(ナミックス㈱)	10:10	4C2-1 (0068) 「Through Silicon Via用硫酸銅電解めっきプロセスの開発」 須賀悠介(㈱社JCU)
10:30	4A2-2 (0069) 「伸縮性導電性ベスト配線の非線形電気抵抗変動と抵抗安定化挙動の解析」 井上雅博(群馬大学)	10:25	4B2-2 (0108) 「はんだ印刷工程における基板表面凸部を考慮した品質予測技術」 永野里奈(㈱東芝)	10:30	4C2-2 (0076) 「ガラス基板への高密着性シード層形成」 坂井寿和(石原ケミカル㈱)
10:50	4A2-3 (0093) 「異なる還元雰囲気下での真空紫外光照射による酸化銅の改質」 片山魁人（大阪公立大学）	10:40	4B2-3 (0110) 「Co-Packaged Optics向け超小型106Gb/s × 8チャネルリニアドライバVCSELトランシーバ」 吉田航(古河電気工業 ㈱)	10:50	4C2-3 (0091) 「ToF-SIMSによるマイクロピタ底の元素分析評価」 西嶋雅彦(大阪大学)
11:10	休憩（10分）				
11:20	A・B会場入室不可 (レイアウト変更)			11:20	(C会場サテライト予定) 4D3 D会場 ポスターショートプレゼンテーション 21件（1件2分以内のプレゼンテーション、質疑なし） 1:藤野晶仁(田中貴金属工業㈱)、2:久場駿佑(関西大学)、3:西尾謙吾(ウシオ電機㈱)、4:YuHaYoung(Korea Institute of Industrial Technology)、5:神山孝一(㈱社メイコー)、6:山本雄一郎(㈱プロテリアル金属)、7:梅堀拓未(信州大学)、8:李相民(大阪大学)、9:森崇亮(㈱大阪ソーダ)、10:Kim Byeongchan(Korea institute of industrial technology, Korea university)、11:横山真心(東京工芸大学)、12:倉島優一((国研)産業技術総合研究所)、13:石岡弘成(東北大学)、14:泉小波((国研)産業技術総合研究所)、15:山本圭一(㈱日本スベリア社)、16:荒井悠綺(長野工業高等専門学校)、17:宮田拓実(長野工業高等専門学校)、18:中村省三(広島工業大学)、19:金山真宏(島根県産業技術センター)、20:塩谷サユ(ウシオ電機㈱)、21:Kim Byeongchan(Korea institute of industrial technology, Korea university)
12:00				休憩（10分）	
12:10	4P4 ポスターセッション1・企業展示コアセッション 1 6階展示会場 ポスター展示：21所属 12:10～13:10 奇数番号、13:10～14:10 偶数番号の発表 ※PrgNo.4D3 参照 企業展示：17社 A:㈱ミツワフロンテック、B:丸文㈱、C:タカヤ㈱、D:奥野製薬工業㈱、E:㈱日立パワーソリューションズ、F:(同)プリマテック、G:ティール・エイ・インスツルメント・ジャパン㈱、H:㈱サーモグラフィティクス、I:テクノアルファ㈱、J:レーザーテック㈱、K:㈱図研、L:サンエレック㈱、M:電子科学㈱、N:キーサイト・テクノロジー㈱、O:積水化学工業㈱、P:ウシオ電機㈱、Q:日立ハイテック㈱ コーヒースポンサー：オムロン㈱			12:10	昼食休憩（120分） C・D会場利用可能
14:10	休憩（10分）				
14:20	4Q5 表彰式 A・B会場（C・D会場サテライト） 司会：実行委員長 第34回マイクロエレクトロニクスシンポジウム（MES2024）ベストペーパー賞:5件、研究奨励賞:5件 ポスターアワード:2件 表彰報告 MES論文委員長 第39回春季講演大会 優秀賞:5件、研究奨励賞:5件、ポスターアワード:1件 受賞者紹介 第39回春季講演大会プログラム副委員長 表彰・権授与：JIEP会長 日暮栄治（東北大学） JIEP会長挨拶 日暮栄治（東北大学）、MES2025組織委員長挨拶 西川宏（大阪大学）				
14:50	休憩（10分）				
15:00	4R6-1 (0101) 特別講演1 A・B会場（C・D会場サテライト） 司会：論文委員長 紹介：組織委員長 「2030年に向けた半導体未来シナリオ」 大野誠 氏（インテル株式会社 代表取締役社長）				
16:00	休憩（10分）				
16:10	4R6-2 (0102) 特別講演2 A・B会場（C・D会場サテライト） 司会：論文委員長 紹介：組織委員長 「産業の川上「結晶」が拓くグリーン・デジタル社会」 森勇介 氏（大阪大学大学院 工学研究科電気電子情報通信工学専攻 教授）				
17:10	移動（30分）				17:15 A・B会場 退出誘導 17:20～18:00 A・B会場 レイアウト変更
17:40	4S7 交流会 レストランアラスカ フェスティバルタワー ※事前申込必要 司会：実行副委員長				
19:30	終了				
19:40	解散				

MES2025 プログラム (一般講演・依頼講演)							
2025年9月5日(金) 開始時間 9:20 【受付開始 8:40】							
A会場 (10階ホール3・4)		B会場 (10階ホール1・2)		C会場 (7階セミナー室7C・7D)		D会場 (7階セミナー室7A・7B)	
信頼性技術1、 マイクロメカトロニクス実装技術		企業プレゼンテーション 8社 (1社: 10分以内 質疑なし)		光回路実装技術、 先端プロセス・実装技術1		シミュレーション・計算機による評価・設計	
9:20	5A1-1 (0024) 「Siダイ/アンダーフィル界面の疲労き裂進展におよぼすSiダイ表面形態の影響」 大木勇汰 (芝浦工業大学)	9:20	5B1-1 (0008) (同)プリマテック 「脆性材料のスライブ加工」	9:20	5C1-1 (0038) 「超伝導量子アニーリング回路の空洞共振モードを抑制するためのTSV・裏面配線工程」 渡辺直也 ((国研)産業技術総合研究所)	9:20	5D1-1 (0061) 「エポキシ樹脂の熱硬化過程におけるフィラーの影響の解析」 辻淳一 (株式会社東リリサーチセンター)
9:40	5A1-2 (0025) 「等2軸熱応力下におけるAgナノ粒子焼結体の疲労破壊挙動におよぼす加圧焼結の影響」 石井利穂 (芝浦工業大学)	9:30	5B1-2 (0040) テクノアルファ(株) 「テクノアルファ株式会社(パワーエレクトロニクス関連商材のご紹介)」	9:40	5C1-2 (0080) 「ミニマルファブを用いた多品種少量IoTセンサシステム向け先端パッケージングの開発」 居村史人 (株式会社Hundred Semiconductors)	9:40	5D1-2 (0094) 「Cu-Si3N4絶縁基板の接合界面評価」 巽裕章 (大阪大学)
		9:40	5B1-3 (0085) キーサイト・テクノロジー(株) 「新・ADS 光電融合設計ソリューション」				
10:00	5A1-3 (0026) 「車載用コネクタはんだ接合部の熱・振動複合負荷疲労寿命計算におよぼす組織粗大の影響」 山崎大瑚 (芝浦工業大学)	9:50	5B1-4 (0031)ティー・エイ・インスツルメント・ジャパン(株) 「温度・湿度変化下における膨張、粘弾性の測定装置と導電ペースト焼結過程の測定事例」	10:00	5C1-3 (0032) 「ポリマー光導波路の低損失化にむけた形状設計」 佐々木この (京セラ(株))	10:00	5D1-3 (0030) 「アダプティブ粒子法を用いたリフロー解析」 北風慎吾 (株式会社JSOL)
		10:00	5B1-5 (0049) (株)図研 「部品内蔵基板と半導体パッケージング工程へのシステム設計アプローチ」	10:00	5C2-1 (0035) 「CPOモジュールにおける光導波路と光ファイバの高精度接続技術の開発」 榎本昇恒 (京セラ(株))	10:00	5D2-1 (0073) 「ITO透明導電膜を利用した広帯域透明アンテナの放射特性の改善」 簡浦希望 (東京工芸大学)
10:20	5A2-1 (0077) 「ガラスインターポーザに向けた40μmピッチはんだ接合部の信頼性評価」 加藤直子 (日本アイ・ピー・エム(株))	10:30	5B1-6 (0004) 奥野製薬工業(株) 「低温Cu-Cu接合用硫酸銅めっき添加剤」	10:30		5C2-2 (0112) 【依頼講演】 「光電コパッケージ技術の最新動向と光エングジン内蔵パッケージ基板の研究開発」 乗木暁博 氏 ((国研)産業技術総合研究所)	
10:50	5A2-2 (0090) 「SnBi 微細バンパ接続のはんだ凝固点とアンダーフィル物性がチップ反りに与える影響」 戸川実栄 (ソニーセミコンダクタソリューションズ(株))	10:40		5D2-3 (0051) 「製造工場における設備生産能力の算出手法と多変量解析を用いた予測モデルの構築」 木本正人 (キオクシア(株),大阪大学)			
11:10	5A2-3 (0082) 「マイクロ・ナノ材料のSEM内その場観察一軸引張試験技術」 生津賢大 (京都先端科学大学)						
11:30	SP-3 ポスターセッション2・企業展示コアセッション2 6階展示会場 ポスター展示: 21所属 11:30～12:15 偶数番号、12:15～13:00 奇数番号の発表 1:藤野晶仁(田中貴金属工業(株))、2:久場駿佑(関西大学)、3:西尾謙吾(ウシオ電機(株))、4:YuHaYoung(Korea Institute of Industrial Technology)、5:神山孝一(株式会社メイコー)、6:山本雄一郎(株式会社リアル金属)、7:梅堀拓未(信州大学)、8:李相民(大阪大学)、9:森崇亮(株式会社大阪ソーダ)、11:横山真心(東京工芸大学)、12:倉島優一((国研)産業技術総合研究所)、13:石岡弘成(東北大学)、14:泉小波((国研)産業技術総合研究所)、15:山本圭一(株式会社スベリア社)、16:荒井悠綺(長野工業高等専門学校)、17:宮田拓実(長野工業高等専門学校)、18:中村省三(広島工業大学)、19:金山真宏(島根県産業技術センター)、20:塩谷サユ(ウシオ電機(株))、10 & 21:Kim Byeongchan(Korea institute of industrial technology, Korea university) 企業展示: 17社 A: (株)三ツフロンテック、B:丸文(株)、C:タカヤ(株)、D:奥野製薬工業(株)、E: (株)日立パワーソリューションズ、F: (同)プリマテック、G: ティー・エイ・インスツルメント・ジャパン(株)、H: (株)サーモグラフィティクス、I: テクノアルファ(株)、J: レーザーテック(株)、K: (株)図研、L: サンコレック(株)、M: 電子科学(株)、N: キーサイト・テクノロジー(株)、O: 積水化学工業(株)、P: ウシオ電機(株)、Q: 日立ハイテク(株) コーヒースポンサー: オムロン(株)			昼食休憩 (90分) A・B・C・D会場利用可能			
信頼性技術2		最先端材料		先端プロセス・実装技術2		パワーエレクトロニクス実装技術	
13:00	5A4-1 (0054) 「p型およびn型熱電半導体/金属界面における接触抵抗の形状依存性」 郷原陽向 (京都工芸繊維大学)	13:00	5B4-1 (0058) 「カーボンナチューブ導電性ペーストの動的パーコレーション速度論とフィラー形状因子」 花田朋也 (群馬大学)	13:00	5C4-1 (0097) 「熱硬化性樹脂由来活性炭の賦活条件による細孔構造とEDLC特性の変化」 大山峻介(大阪公立大学)	13:00	5D4-1 (0010) 「Si-MOSFET製品のはんだボイドが過渡熱抵抗に与える影響」 林祐太郎 (東芝デバイス&ストレージ(株))
13:20	5A4-2 (0012) 「熱電半導体/金属界面の接触抵抗計測によるデバイス構造最適化」 桂章皓 (京都工芸繊維大学)	13:20	5B4-2 (0057) 「銅マイクロ/サブミクロンフィラー含有導電性ペーストのキュア過程導電バス発達の解析」 内田歩海 (群馬大学)	13:20	5C4-2 (0065) 「酢酸による金属塩被膜を付与したSn-Znはんだの基板実装性評価」 山崎浩次 (群馬大学)	13:20	5D4-2 (0023) 「過渡熱マネジメントに向けた蓄熱材含浸ボラス金属の構造最適化」 小林亮平 (住友電気工業(株))
13:40	5A4-3 (0021) 「パワーサイクル試験時のSiC-MOSFET負ゲート電圧の影響」 加藤史樹 ((国研)産業技術総合研究所)	13:40	5B4-3 (0033) 「銀シードセミアディティブ法によるBUF上への微細銅配線形成」 村川昭 (DIC(株))	13:40	5C4-3 (0081) 「冷却速度と高温放置がSn-3.0Ag-0.5Cuはんだの組織と硬度に及ぼす影響」 村田夢実 (大阪大学)	13:40	5D4-3 (0072) 「表面濡れ性差を利用した擬似弾性液体金属を用いた熱層間材料」 後藤拓 ((国研)産業技術総合研究所)
14:00	5A4-4 (0022) 「ダイヤタッチはんだ接合内部における亜粒界分布の非破壊可視化」 林雄二郎 (理化学研究所)	14:00	5B4-4 (0028) 「埋込性に優れた熱伝導性樹脂フィルム基板材の開発とその放熱評価」 徳久憲司 (古河電気工業(株))	14:00	5C4-4 (0092) 「NiFeフィラーを用いた液相拡散接合の熱履歴による接合状態の調査」 佐々木智揮 (千住金属工業(株))	14:00	5D4-4 (0067) 「パワーサイクル試験におけるAIワイヤ接合部の劣化挙動の評価」 許育甄 ((株)東芝)
14:20	休憩 (10分)						
14:30	5A5-1 (0020) 「SMD インダクターにおけるはんだ接合部のエレクトロマイグレーションの調査」 辻井大明 ((株)村田製作所)	14:30	5B5-1 (0053) 「脂環式エポキシ樹脂バインダーの配合による銀マイクロフィラー低温焼結へ及ぼす影響」 福島孝典 (群馬大学,日本学術振興会)	14:30	5C5-1 (0083) 「突合せ接合したアルミニウムと銅の摩擦攪拌接合を利用した易分離」 石貝拓磨 (群馬大学)	14:30	5D5-1 (0034) 「デジタル画像相関法を用いたAg粒子焼結体の変形挙動調査」 小野涼翔 (大阪大学)
14:50	5A5-2 (0060) 「Low-k配線の構造がエレクトロマイグレーション損傷のしきい電流密度へ及ぼす影響」 本多生昌 (弘前大学)	14:50	5B5-2 (0096) 「ナノ粒子含有エポキシ樹脂の硬化前後における粒子分散状態と膜物性の関係」 石田堅翔 (大阪公立大学)	14:50	5C5-2 (0089) 「突合せ接合した異種金属接合材の易解体技術開発」 半谷禎彦 (群馬大学)	14:50	5D5-2 (0041) 「ZnAl共析合金の冷却前溶体化時間と冷却後の結晶粒径の関係」 寺地智紀 (鹿児島大学)
15:10	5A5-3 (0064) 「樹脂封止型中空パッケージの高信頼性化に向けた反り挙動観察」 梶山直樹 (ソニーセミコンダクタソリューションズ(株))	15:10	5B5-3 (0055) 「数十～数百nmサイズ結晶粒の3次元非破壊イメージング」 押目典宏 (QST)	15:10	5C5-3 (0079) 「高アスペクト比TSVにおけるTEOS-CVDを用いた絶縁膜形成プロセス開発」 岡崎天河 (熊本大学)	15:10	5D5-3 (0046) 「ZnAl共析合金を用いた鉛フリー高温接合材料の開発」 岩尾武 (鹿児島大学)
15:30	5A5-4 (0027) 「機械学習と統計的手法を組み合わせたBGA/パッケージはんだ接合部の熱疲労駆動力予測」 加藤遼 (芝浦工業大学)	15:30	5B5-4 (0070) 「水溶液中に分散したグラフェンに対するinsituラマンによる構造解析」 田中雄登 (大阪公立大学)	15:30		15:30	5D5-4 (0084) 「電気アシストによるA5052/C1020の高信頼性接合法の検討」 小山真司 (群馬大学)
15:50	終了						